



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号  
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20130322000

2013 年 3 月 25 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社  
営業・技術本部 カスタマドキュメント  
マネージャ 牧 達郎 

HPA SSOP(DB)パッケージ 一部製品 組立サイト追加のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただいたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは [pcn\\_tij@list.ti.com](mailto:pcn_tij@list.ti.com) にお問い合わせ下さい。

以上

## 変更概要

|        |                                                                                                                         |                                                                                          |                                     |                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 通知タイプ  | <input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Final notice                                         |                                     |                                     |
| 変更概要   | Design/Specification                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Design                                                          | <input type="checkbox"/> Electrical | <input type="checkbox"/> Mechanical |
|        | Wafer Fab                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Site                                                            | <input type="checkbox"/> Process    | <input type="checkbox"/> Material   |
|        | Wafer Bump                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Site                                                            | <input type="checkbox"/> Process    | <input type="checkbox"/> Material   |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Site                                                 | <input type="checkbox"/> Process    | <input type="checkbox"/> Material   |
|        | Test                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Site                                                            | <input type="checkbox"/> Process    |                                     |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> Others                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling <input type="checkbox"/> - |                                     |                                     |
| 変更内容   | HPA SSOP (DB) パッケージ 一部製品 組立サイト追加<br>現行 : CARSEM-S 社(CRS, マレーシア)<br>変更後 : CARSEM-S 社(CRS, マレーシア), CARSEM-M 社(CAR, マレーシア) |                                                                                          |                                     |                                     |
| 対象製品   | 対象製品リスト参照                                                                                                               |                                                                                          |                                     |                                     |
| 変更時期   | 7 月上旬の出荷より予定しています。                                                                                                      |                                                                                          |                                     |                                     |
| 品質認定試験 | <input type="checkbox"/> 計画                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 終了                                                   |                                     |                                     |
| 製品表示   | <input type="checkbox"/> 変更無し                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 変更あり                                                 |                                     |                                     |
| 備考     | -                                                                                                                       |                                                                                          |                                     |                                     |

## 変更内容

内容: 弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) SSOP (DB) パッケージ 一部製品の組立サイトについて、現行 CARSEM-S社(CRS, マレーシア) サイトにて製造していますが、供給能力確保の為に、これに加えて、CARSEM-M社(CAR, マレーシア) サイトを追加します。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

|       |                  |                                      |
|-------|------------------|--------------------------------------|
| 変更内容  | 現行               | 変更後                                  |
| 組立サイト | CARSEM-S社(マレーシア) | CARSEM-S社(マレーシア)<br>CARSEM-M社(マレーシア) |

理由 : 供給能力確保の為

## 対象製品リスト

| 対象製品名       |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DAC7613E    | DAC7614EG4  | DAC7616EBG4 | DAC7621EB   | DAC7731E    |
| DAC7613EB   | DAC7615E    | DAC7616EG4  | DAC7621EBG4 | DAC7731EC   |
| DAC7613EBG4 | DAC7615EB   | DAC7617E    | DAC7621EG4  | DAC7731ECG4 |
| DAC7613EG4  | DAC7615EBG4 | DAC7617EB   | DAC7631E    | DAC7731EG4  |
| DAC7614E    | DAC7615EG4  | DAC7617EBG4 | DAC7631EB   |             |
| DAC7614EB   | DAC7616E    | DAC7617EG4  | DAC7631EBG4 |             |
| DAC7614EBG4 | DAC7616EB   | DAC7621E    | DAC7631EG4  |             |

## 製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地(ラベル箇所: 22L)が下記の様になります。

|      | 組立サイト    | 組立サイトコード(22L) |
|------|----------|---------------|
| 現行   | CARSEM-S | CRS           |
| 追加認定 | CARSEM-M | CAR           |



図1 出荷ラベルの例

## 信頼性試験

## 信頼性試験結果

| 信頼性試験結果                                            |                      |                   |                  |                  |                 |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 信頼性試験期間                                            | 開始                   |                   | 終了               |                  | 2013 年 3 月 21 日 |
| 信頼性試験 - 試料構成詳細                                     |                      |                   |                  |                  |                 |
| Device ID:                                         | Device1              | Device2           | Device3          | Device4          |                 |
| Qual Device:                                       | ADS1213E             | ADS7871IDB        | ADS825E          | PGA2505IDB       |                 |
| Assembly Site:                                     | CAR                  | CAR               | CAR              | CAR              |                 |
| Package/Code/Pins:                                 | SSOP/DB/28           | SSOP/DB/28        | SSOP/DB/28       | SSOP/DB/28       |                 |
| Mount Compound:                                    | 434165               | 434165            | 434165           | 434165           |                 |
| Mold Compound:                                     | 438360               | 438358            | 438360           | 438360           |                 |
| Bond Wire:                                         | 1.3 Mil Dia., AU     | 1.3 Mil Dia., AU  | 1.3 Mil Dia., AU | 1.3 Mil Dia., AU |                 |
| Leadframe (Finish, Base):                          | NiPdAu, Cu           | NiPdAu, Cu        | NiPdAu, Cu       | NiPdAu, Cu       |                 |
| MSL:                                               | JEDEC L-2/260C       | JEDEC L-2/260C    | JEDEC L-2/260C   | JEDEC L-2/260C   |                 |
| 信頼性試験結果                                            |                      |                   |                  |                  |                 |
| Reliability Test                                   | Condition / Duration | Sample Size/Fails |                  |                  |                 |
|                                                    |                      | Device1           | Device2          | Device3          | Device4         |
| Solderability                                      | Pb-Free/Solder       | -                 | -                | 22/0             | -               |
| **Unbiased HAST                                    | 130C/85%RH, 96Hrs    | 77/0              | 77/0             | 77/0             | 77/0            |
| **T/C                                              | -65C/150C, 500Cyc    | 77/0              | 77/0             | 77/0             | 77/0            |
| Manufacturability                                  | Assembly Site        | Approved          | Approved         | Approved         | Approved        |
| Physical Dimensions                                | Mechanical drawing   | -                 | -                | 5/0              | 5/0             |
| Moisture Sensitivity                               | JEDEC L-2/260C       | 12/0              | 12/0             | 12/0             | 12/0            |
| Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C. |                      |                   |                  |                  |                 |

## 信頼性試験結果

| 信頼性試験結果                                            |                               |                           |            |                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|
| 信頼性試験期間                                            | 開始                            | —                         | 終了         | 2013 年 3 月 21 日 |
| 信頼性試験 — 試料構成詳細                                     |                               |                           |            |                 |
| Qual Device:                                       | DAC8820IBDB                   |                           | -          | -               |
| Assembly Site:                                     | CAR                           | Package/Code/Pins:        | SSOP/DB/28 |                 |
| Mount Compound:                                    | 434165                        | Mold Compound:            | 438518     |                 |
| Bond Wire:                                         | 1.3 Mil Dia., AU              | Leadframe (Finish, Base): | NiPdAu, Cu |                 |
| MSL:                                               | JEDEC L-2/260C                |                           | -          | -               |
| 信頼性試験結果                                            |                               |                           |            |                 |
| Reliability Test                                   | Condition / Duration          | Sample Size/Fails         |            |                 |
|                                                    |                               | Lot1                      | Lot2       | Lot3            |
| Manufacturability                                  | Assembly Site                 | Approved                  | Approved   | Approved        |
| Solderability                                      | 8 Hrs/Stm Age, Pb-Free/Solder | 22/0                      | 22/0       | -               |
| **Unbiased HAST                                    | 130C/85%RH, 96Hrs             | 77/0                      | 77/0       | 77/0            |
| **T/C                                              | -65C/150C, 500Cyc             | 77/0                      | 77/0       | 77/0            |
| Physical Dimensions                                | Mechanical drawing            | 5/0                       | -          | -               |
| Moisture Sensitivity                               | JEDEC L-2/260C                | 12/0                      | 12/0       | -               |
| Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C. |                               |                           |            |                 |